

水平式連続両面スプレーコーター

[装置概要]

本装置は、液状フォトソルダーレジストインキを水平搬送されてくる基盤に対して、上部よりエア霧化式スプレーガンにより、搬送方向と直交する軸上をスキヤニングしながらコーティングする装置です。又、表面塗布後は自動的に基板を反転させ連続で裏面を塗布します。

[特 徴]

(1)

基板を水平搬送する為のクランプハンドは、必要最小限な保持面積でありながら、任意の位置で反転可能な機構を有する新規開発のものです。又、幅方向の基板サイズ変更に対応するよう自動可動式になっています。

(2)

高い塗着効率を実現させる為、従来の常識的な被塗装体（基板）とスプレーノズルとの距離を極端に短くし、噴射された塗料粒子の初速を極力維持させ塗着させる近距離塗布方式を新規に採用しています。

(3)

枚葉式装置の為、スプレー作業時はブース内が完全に密閉状態となり、スプレーミストのブース外流出を極力抑えられる構造になっています。又、密閉ブースの為給排気のバランスが常に保たれています。更に、外部からの塵、ホコリ等の異物の侵入も防ぎます。

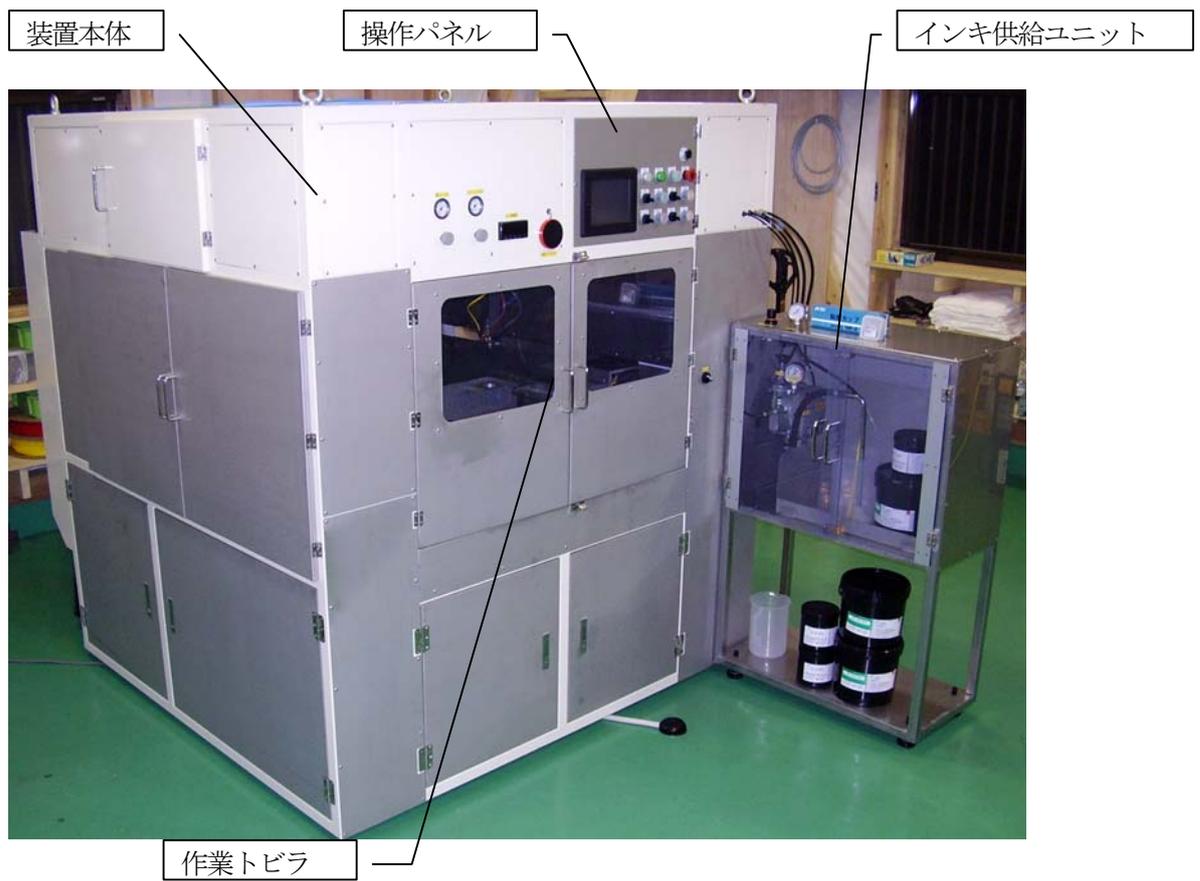
[基本仕様]

機	長	:	2 6 9 0 mm	(インキ供給ユニット含む)
機	幅	:	2 0 0 0 mm	
機	高	:	1 9 5 0 mm	
基 板 サ イ ズ	:	3 0 0 mm (w) × 2 0 0 mm (L) ~ 5 1 0 mm (w) × 6 1 0 mm (L)		
基 板 板 厚	:	0. 8 ~ 5. 0 mm	0. 4 ~ 0. 6 mmはサイズに制限有	
処 理 能 力	:	4 5 秒/枚	(4 1 0 mm (w) × 3 3 0 mm (L))	
			※ 塗布条件により異なります。	
塗 布 方 式	:	エア霧化式スプレーによるスキヤニング方式		
ノズルスキヤンストローク	:	6 5 0 mm(MAX) ~ 4 5 0 mm (MIN)		
			(ワークサイズにより自動変更)	
給	気	:	3 0 M ³ /m i n (室内より)	フィルター付

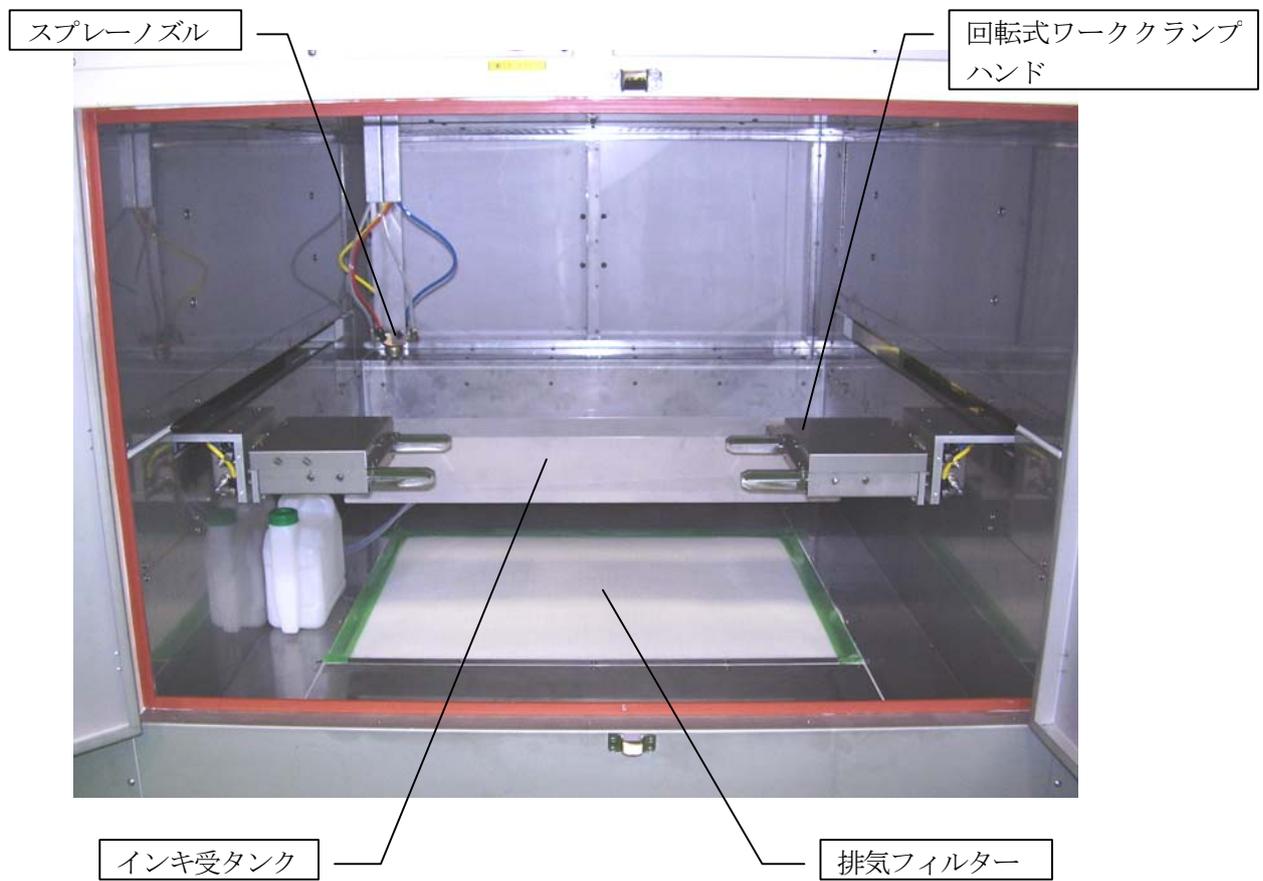
排 気 : 30M³/min フィルター付 (1.5kw 防爆ブロワ)
φ200mm

電 源 : AC200V 3φ 2.9KW

エ ア ー : 6±1Kg/cm², 450Nl/min (ドライエアー)



[装置全体図]



[ブース内部]



インキポンプ

[インキ圧送ユニット]



[ワーク搬送状態]

水平式連続両面スプレーコーター 半自動タイプ

基本仕様書

